

2026年3月18日

各位

公司名 尼得科精密检测科技株式会社
代表人 董事长总经理 山崎 秀和
地 址 京都府向日市 Nidec Park33 C 栋

尼得科精密检测科技株式会社将参展 SEMICON China 2026

尼得科精密检测科技株式会社将参展于 2026 年 3 月 25 日（星期三）~3 月 27 日（星期五）在上海新国际博览中心举办的“SEMICON China 2026”。



大会覆盖了芯片设计、制造、封装、测量、设备、材料等全产业链，是中国国内最大规模的半导体行业展览会之一，聚集了超过 1,000 家企业，设有超过 4,500 个展位。

尼得科精密检测科技除了将展出用于半导体晶圆检测的光学外观检测设备、探针卡之外，还将在中国首次展出新开发的 MLO 基板（Multilayer Organic Substrate）。该基板可大幅提升布线密度，同时支持高速信号传输，在持续迈向精细化的半导体检测工序中，备受瞩目。

此外，尼得科集团旗下尼得科仪器株式会社也将携其半导体晶圆搬运机器人共同参展。该公司高水平的晶圆搬运机器人将与本公司的检测技术相融合，联合为全球的半导体制造工序提供极具前沿性的检测与搬运产品解决方案。

敬请莅临！

〈展会概要〉

- 会期：2026 年 3 月 25 日（星期三）~3 月 27 日（星期五）
- 会场：上海新国际博览中心
- 展位：E6713
- 官网：<https://www.semiconchina.org/>

〈参展内容〉

- 3D/2D/SD 半导体晶圆凸点检测设备 RWi-300MK3
- 支持大型基板的 3D/AFVI+AI 检测设备 AURCA 系列

- 面向半导体晶圆及 PLP 的 2D+3D 检测解设备 AURCA-S 系列
- 面向 TGV 的高精度 2D/3D 检测解决方案
- 功率半导体前端/后端检测解决方案
- 探针卡用 MLO 基板
- 半导体晶圆检测用探针卡
- 半导体晶圆搬运机器人